

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【公開番号】特開 2005-274594(P2005-274594A)

【公開日】平成 17 年 10 月 6 日 (2005.10.6)

【年通号数】公開・登録公報 2005-039

【出願番号】特願 2004-83353(P2004-83353)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

G 0 3 F 7/38 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/004 5 2 1

G 0 3 F 7/004 5 0 1

G 0 3 F 7/38 5 1 2

H 0 1 L 21/30 5 6 8

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 14 日 (2007.3.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

請求項 4 に記載のレジストパターンの形成方法を用い、基板にレジストパターンを形成する工程と、

前記工程によりレジストパターンの形成された基板を、ドライエッチング、ウエットエッチング、金属蒸着、リフトオフまたはめっき、を行う工程と、

を有することを特徴とする基板の加工方法。